

## 信頼性試験結果 Reliability Test

### XCL205シリーズ

### XCL205 Series

パッケージ

Package

:

CL-205

RoHS対応品 RoHS Compliance

ハロゲン/アンチモンフリー Halogen &amp; Antimony-Free

| No. | 試験項目<br>Test Item                        | 試験条件<br>Test Conditions   | 時間<br>Hours | 試験結果<br>Result<br>r/n |
|-----|--|---|-------------|-----------------------|
| 1   | 高温バイアス<br>High Temperature Bias          | 105°C VIN=6.3V  | 1000        | 0/22                  |
| 2   | 高温保存<br>High Temperature Storage         | 105°C   | 1000        | 0/22                  |
| 3   | 高温高湿保存<br>Temperature Humidity Storage   | 60°C90%RH   | 1000        | 0/10                  |
| 4   | 温度サイクル<br>Temperature Cycle<br>(Gaseous) | -40°C~105°C 各30分<br>30min Each  | 100CYC.     | 0/22                  |
| 5   | はんだ耐熱<br>Resistance to Soldering Heat    | 85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times<br>→85°C85%RH24h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)1time<br>Moisture Sensitivity Level 1<br>IPC/JEDEC J-STD-020D 準拠<br>Based on JEDEC-STD-020D |             | 0/22                  |

### IC単体データ

### IC data

| No. | 試験項目<br>Test Item                  | 試験条件<br>Test Conditions                               | 試験結果<br>Result<br>r/n |
|-----|------------------------------------|---|-----------------------|
| 1   | 静電耐圧<br>Electric Static Discharge. | R=0Ω C=200pF ±200V以上 各端子3回<br>±200V over 3times Each  | 0/20                  |
|     |                                    | R=1500Ω C=100pF ±1kV以上 各端子3回<br>±1kV over 3times Each |                       |
| 2   | ラッチアップ<br>Latch-Up                 | R=0Ω C=200pF ±100V以上 各端子3回<br>±100V over 3times Each  | 0/5                   |
|     |                                    | 50mA以上<br>50mA over                                   |                       |

### パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

| No. | 試験項目<br>Test Item                | 試験条件<br>Test Conditions  | 試験結果<br>Result<br>r/n |
|-----|----------------------------------|--|-----------------------|
| 1   | 接合強度試験<br>Adhesive strength test | PKG側面を10N 10秒間加圧する (EIAJ ED7403)<br>apply a pressure of 10N on the side face of the PKG for 10sec. | 0/5                   |
| 2   | 基板反り試験<br>Bending Test           | たわみ量 5mm 5±1s 1回/1time (EIAJ ED4702)<br>Strain   | 0/5                   |
| 3   | はんだ付け性<br>Solderability          | 230°C10秒(プロファイル昇温法)<br>10s (Temperature profile method )   | 0/11                  |